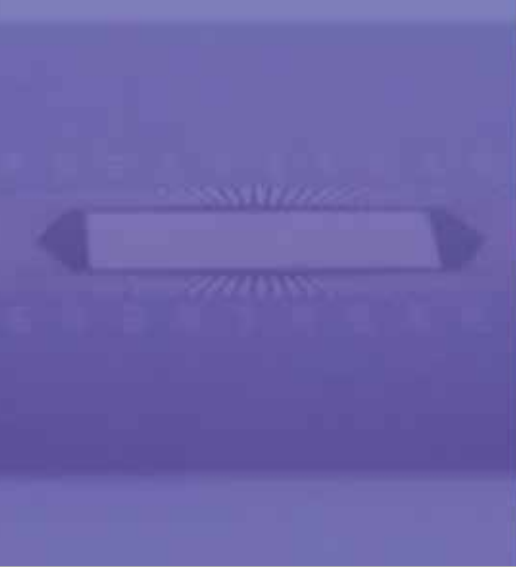




기종명

PSX307

품번: NM-EFP1A

COST DOWN

비용 절감

에 최적

기종명	PSX307
품번	NM-EFP1A
클리닝방식	고주파 평행 평반 역스퍼터 방식
방전용가스 ^{※1}	아르곤 가스(옵션: 산소)
기판크기	L 50 mm × W 20 mm to L 250 mm × W 75 mm ^{※2} (S 사이즈 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함) L 50 mm × W 20 mm to L 330 mm × W 120 mm (M 사이즈 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함)
기판두께	0.5 mm ~ 2.0 mm
설비크기/무게 ^{※3}	W 930 mm × D 1,100 mm × H 1,450 mm / 555 kg W 1,764 mm × D 1,100 mm × H 1,450 mm / 850 kg (S 사이즈 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함) W 1,764 mm × D 1,100 mm × H 1,450 mm / 725 kg (M 사이즈 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함)
전원 ^{※4}	단상 AC 200 V, 2.00 kVA (피크 시: 5.00 kVA)
공압	0.49 MPa 이상, 6.5 L/min (A.N.R.)

※ 자세한 사항은 사양설명서를 참조해주시기 바랍니다.

※1: 방전용 가스에 옵션의 산소 가스를 선택할 경우, 별도 배기 회석용 질소 가스도 필요합니다.

※2: W 70.1mm ~ W 75mm는 Chamber 내 전극이 별도로 필요합니다.

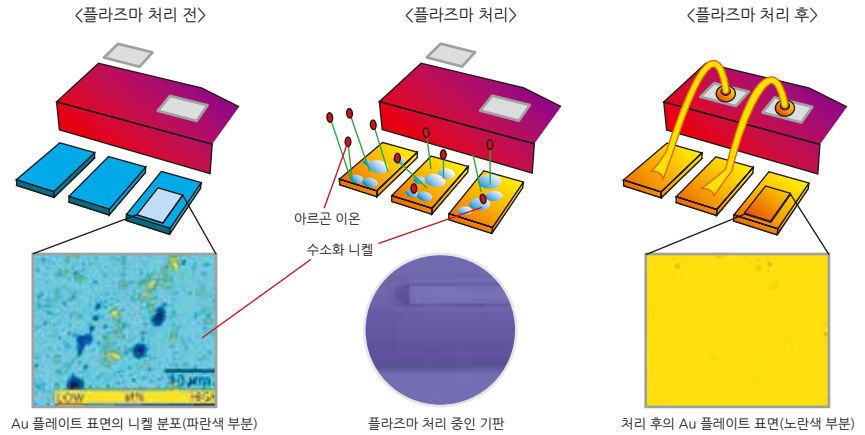
※3: 설비 크기의 허용 범위는 ±5mm입니다. 터치 패널, 상황 표시등은 제외합니다.

설비 무게는 구성에 따라 상이할 수 있습니다.

※4: 단상 208 / 220 / 230 / 240 V에도 대응 가능합니다.

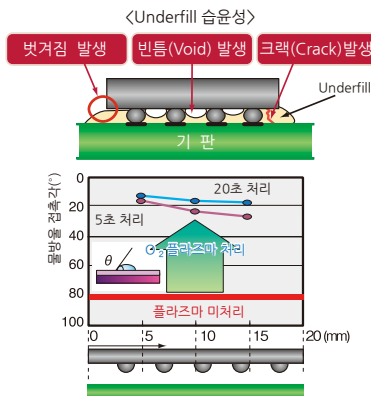
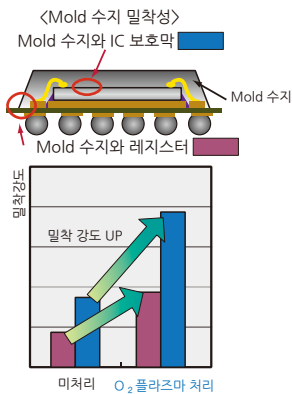
■ 아주 얇은 금 플레이트(extra-thin gold plated electrode)를 사용할 수 있는 이유

값이 저렴한 아주 얇은 금 플레이트로는 Die-Bonding Cure의 열 처리에 따라 표면에 니켈 화합물이 형성됩니다. 이 니켈 화합물은 Wire Bonding성을 저해하기 때문에 기존의 얇은 금 플레이트는 Wire Bonding에 적합하지 않았습니다. PSX307로는 아르곤 플라즈마 처리에 의해 니켈 화합물을 제거하고, 극도로 얇은 금 플레이트에 안정된 Wire Bonding이 가능합니다.



■ 산소 플라즈마에 의한 표면 개선

산소 래디칼(Radical)을 이용한 표면 질 개선에 따라, Mold 수지 밀착성, Underfill 습윤성의 개선이 가능합니다. (옵션)



■ 반송계 옵션



M 타입
 M 타입 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함



S 타입
 S 타입 반송계와 로더/언로더의 옵션 포함

⚠ 안전에 관한 주의사항

● 제품을 사용하실 때에는 취급설명서를 숙지한 후 올바른 방법으로 사용해주시요.

● 본 카탈로그에 기재된 제품의 안전한 사용을 위해 설비의 가동·정지에 관계없이 설비에 첨부된 취급설명서 및 설비에 부착된 경고 문구를 충분히 확인하신 후, 올바른 조작을 부탁드립니다.

Panasonic은 친환경 제품 만들기에 최선을 다 하고 있습니다

자세한 사항은,
panasonic.com/global/corporate/sustainability

문의 사항 기재란

Panasonic Corporation
 Process Automation Business Division

3-1-1 Inazu-cho, Toyonaka City, Osaka 561-0854, Japan
 TEL +81-6-6866-8675
 FAX +81-6-6862-0422

본 자료의 기재 내용은
 2021년 1월 1일 기준입니다.

Ver.2021.1.1

© Panasonic Corporation 2021